



2017年7月13日

各 位

フレキシブル基板用電解銅箔の生産体制増強

～マレーシア工場の生産能力を20%増強へ～

当社（社長 西田計治）は、フレキシブル基板（※1）用電解銅箔の生産能力を従来比で20%増強することを決定しましたので、お知らせいたします。

当社のフレキシブル基板用電解銅箔は、高伸び特性と高屈曲特性を特徴とする「Super HTE™」を主力製品として、お客さまに高い評価を頂いており、高品質と安定した供給が可能なことから世界No.1の市場シェアを獲得しております。

最近では、スマートフォン市場の成長と高機能化を背景として販売量が大幅に増加しており、この需要に対応するべく主力工場であるマレーシア工場（Mitsui Copper Foil (Malaysia) SDN. BHD.）の遊休表面処理設備を2ライン刷新することで生産体制を従来比で20%増強し、2017年8月より順次稼働を開始いたします。これにより、フレキシブル基板用電解銅箔の旺盛な需要にお応えすることが可能となります。

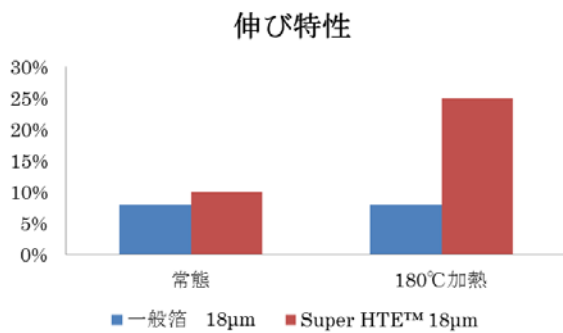
当社のスローガンである「マテリアルの知恵を活かす」のもと、安定した品質を維持し、お客様への十分な供給能力を確保してまいります。

以 上

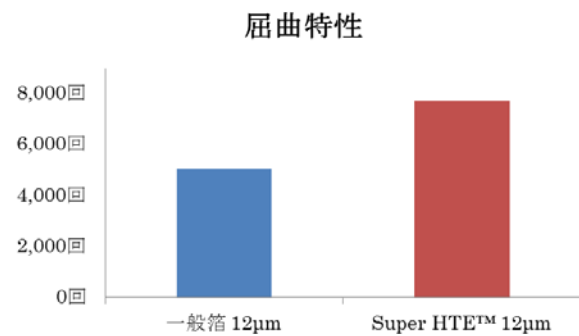
【お問い合わせ先】

三井金属 経営企画本部 広報部 TEL 03-5437-8028 FAX 03-5437-8029

Eメール PR@mitsui-kinzoku.co.jp



常態と 180°C加熱時の伸び特性



IPC 屈曲性試験結果

フレキシブル基板用電解銅箔「Super HTE™」の代表特性

(補足)

※1 フレキシブル基板

…ポリイミド等の屈曲性が高く薄い絶縁材に、銅箔等の導電性金属で電気回路を形成した柔軟性のある回路基板

(ご参考)

Mitsui Copper Foil (Malaysia) SDN. BHD.について

- (1) 名称 : Mitsui Copper Foil (Malaysia) SDN. BHD.
- (2) 所在地 : セランゴール州、マレーシア
- (3) 社長 : 手嶋 裕二
- (4) 設立 : 1989年4月
- (5) 資本金 : 330,000千マレーシアリングgit
- (6) 出資者 : 当社 100%
- (7) 事業内容 : プリント配線板用銅箔の製造